

2013年度(H25年度) 第2回 フットニックデバイス・応用技術研究会

・日時: 平成25年7月24日(水) 13:00~17:00 講演会
17:00~18:00 懇親会

・会場: 機械振興会館 研修2(地下3階)

★★★光通信用デバイス大容量化の最前線~400G/1Tbpsへの鍵 ★★★

第2回研究会担当幹事より

本年度第2回研究会では、会員の皆様へのアンケート結果でご要望が多かったテーマ(光電子実装技術、光導波路技術、光ファイバ技術、VCSEL等)を包含しつつ、今後急速に進展すると予測される光通信デバイスの大容量化に向けた技術課題と解決策について深掘りした議論ができるよう、趣向を変え下記のようなプログラム構成といたしました。皆様にとってより興味深く、有意義な研究会となることを期待しております。

光通信用デバイス大容量化の最前線~400G/1Tbpsへの鍵

・100Gb/s級の光デバイスと、そこで使われるモノリシック/ハイブリッド集積化技術、電気/光実装技術など、小型かつ大容量な光デバイスを実現するにあたって鍵となる要素技術について、①インターコネクション②イーサネット③テレコム各分野から一件ずつ講師の皆様にご講演いただき、さらなる大容量化に向けた課題と解決策について議論します。

・講師の方とのより深い意見交換が図れるよう、試験的に新しい形態でのポスターセッションを企画いたしました。

・講演とリンクして、日本オクラロ株式会社平本様より、3月に正式にスタディグループの立上った次世代400GbE標準化の動向と光トランシーバの実現に向けた最新技術動向についてご報告をいただきます。

⇒ プログラム詳細は次頁へ

講演プログラム (講演順は変更される可能性があります)

13:00 ~ 13:10

オリエンテーション

13:10 ~ 14:00

装置内光インターコネクト向け100Gb/s CMOS光トランシーバの開発(仮)

株式会社 日立製作所

竹本 享史

14:10 ~ 14:50

100GbE向けTOSA/ROSAを実現するハイブリッド集積技術

三菱電機株式会社

望月 敬太

15:00 ~ 15:40

InP系90° ハイブリッド集積型pin-PDとこれを用いた100Gb/s小型コヒーレントレシーバ

住友電気工業株式会社

米田 昌博

15:40 ~ 16:20

ポスターセッション

16:20 ~ 17:00

次世代400GbE標準化の動向と光トランシーバの実現に向けた最新技術動向

日本オクラロ株式会社

平本 清久

17:00 ~ 18:00

懇親会

担当幹事： 日本電信電話株式会社
株式会社 日立製作所

大野 哲一郎
足立 光一郎

事務局： 一般財団法人光産業技術振興協会

三浦 貴光